

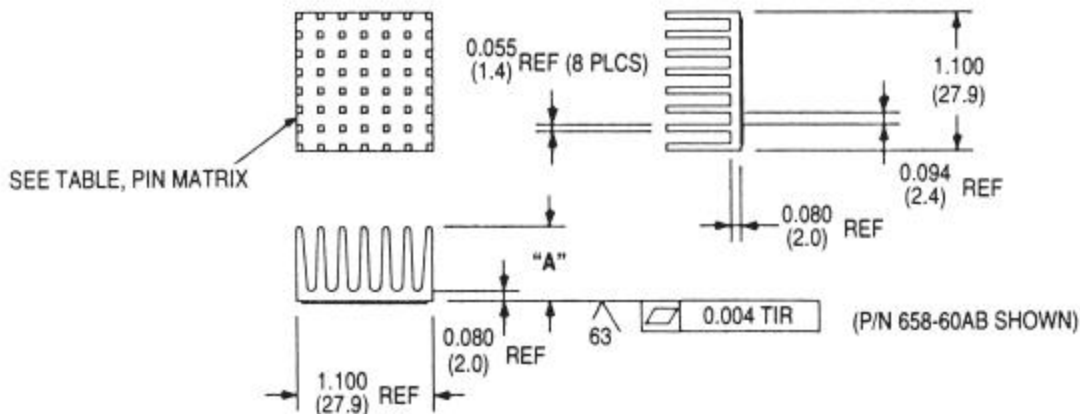
wakefield-vette

658 SERIES

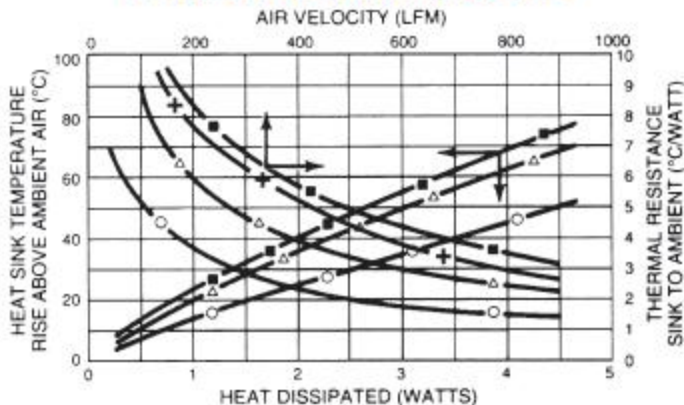
Omnidirectional Pin Fin Heat Sink for BGAs and PowerPC™

Standard P/N	Base Dimensions in. (mm)	Dimension "A" in. (mm)	Typical Applications	Heat Sink Finish	Weight lbs. (grams)
658-25AB	1.100 (27.9) sq	0.250 (6.4)	27mm BGA	Black Anodized	0.013 (5.67)
658-35AB	1.100 (27.9) sq	0.350 (8.9)	27mm BGA	Black Anodized	0.015 (6.70)
658-45AB	1.100 (27.9) sq	0.450 (11.4)	27mm BGA	Black Anodized	0.019 (8.50)
658-60AB	1.100 (27.9) sq	0.600 (15.2)	27mm BGA	Black Anodized	0.031 (14.17)

Notes: 1. Optional factory preapplied pressure-sensitive adhesive. See Page 3



NATURAL AND FORCED CONVECTION CHARACTERISTICS



KEY: ■ 658-25AB + 658-35AB △ 658-45AB ○ 658-60AB

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Heat Sinks](#) category:

Click to view products by [Wakefield](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[581102B00000G](#) [630-35ABT3](#) [656-15ABPE](#) [657-20ABPNE](#) [7020B-TC12-MTG](#) [73452PPBA](#) [7G0011A](#) [FI306/SE](#) [PF720G](#) [A22-4026](#) [120-1873-007](#) [HAH10L](#) [HF20](#) [1542256-2](#) [1542026-1](#) [1542616-1](#) [HS-2506-F1](#) [HS-87M0-F2](#) [218-40CTE3](#) [25-7520](#) [188854F00000G](#) [F-QB-F1](#) [APA501-60-003](#) [253-122ABE-22](#) [PSC22CB](#) [CLP-201](#) [CLP212SG](#) [CLP-7701G](#) [HAA072](#) [HAA083](#) [HAF10L](#) [D10100-28](#) [TO5-002D](#) [513101B02500G](#) [BDN183CBA01](#) [531202B0000](#) [HS-56M0-C1](#) [3-21053-4](#) [TX0506-1B](#) [TX1806B](#) [336614B-00000](#) [V2004X](#) [LAE66A3CB](#) [WA-DT2-101E](#) [511-3U](#) [017177](#) [6110BG](#) [73381PPBA](#) [73403PPBA](#) [7G0047C](#)